

北九州PCB処理事業所（1期施設）真空加熱分離設備等解体工事

工 事 の 名 称	北九州PCB処理事業所（1期施設）真空加熱分離設備等解体工事
工 事 概 要	北九州1期設備の内、真空加熱分離設備の解体撤去を実施する。
契 約 年 月 日	令和3年4月21日
契 約 業 者 名	株式会社日立プラントコンストラクション
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
契 約 金 額	金42,768,000円(税込み)
入 札 方 式	一般競争入札
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町一丁目62番24
工 事 種 別	機械設備工事（撤去工事）
工 期（自）	令和3年4月22日
工 期（至）	令和3年9月30日
備 考	

予定価格（消費税抜き）
¥ [REDACTED] 円
調査基準価格（消費税抜き）
¥ [REDACTED] 円

入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者

氏名 [REDACTED] 印

立会者

氏名 [REDACTED] 印

1. 件名 北九州 PCB 処理事業所(1期施設)真空加熱分離設備等解体工事

2. 開札日時 令和3年4月6日 10時00分

業者名	第1回金額	第2回金額	摘要
テックプロジェクトサー ビス(株)	[REDACTED]		
日鉄エンジニアリング(株)	[REDACTED]		
(株)日立プラントコンス トラクション	¥38,880,000 円		落札決定